# (12)特許協力条約に基づ(

# 11 JAN 2005

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



### 

(43) 国際公開日 2004 年1 月22 日 (22.01.2004)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2004/008475 A1

(51) 国際特許分類7:

H01J 37/30,

37/317, 37/20, G01N 1/28, H01L 21/302

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/008691

(22) 国際出願日:

2003 年7 月9 日 (09.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語日本語

(26) 国際公開の言語:

(30) 優先権データ: 特願2002-204028

特願2002-204028 2002年7月12日(12.07.2002) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): セイコーインスツルメンツ株式会社 (SEIKO INSTRUMENTS INC.) [JP/JP]; 〒261-8507 千葉県 千葉市 美浜区中瀬1丁目8番地 Chiba (JP).

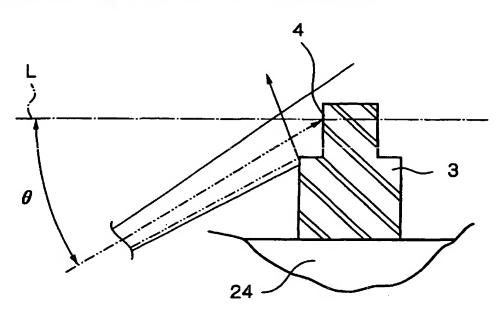
(72) 発明者; および

(72) 発明者; あよい
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 児玉 俊男 (KO-DAMA,Toshio) [JP/JP]; 〒261-8507 千葉県 千葉市美浜区中瀬1丁目8番地セイコーインスツルメンツ株式会社内 Chiba (JP). 荷田昌克 (HASUDA,Masakatsu) [JP/JP]; 〒261-8507 千葉県 千葉市美浜区中瀬1丁目8番地セイコーインスツルメンツ株式会社内 Chiba (JP). 藤井利昭 (FUJII,Toshiaki) [JP/JP]; 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地セイコーインスツルメンツ株式会社内 Chiba (JP). 岩崎浩二(IWASAKI,Kouji) [JP/JP]; 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地セイコーインスツルメンツ株式会社内 Chiba (JP). 杉山安彦 (SUGIYAMA,Yasuhiko) [JP/JP]; 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地セイコーインスツルメンツ株式会社内 Chiba (JP). 高木康行 (TAKAGI,Yasuyuki) [JP/JP];

/続葉有/

(54) Title: ION BEAM DEVICE AND ION BEAM PROCESSING METHOD, AND HOLDER MEMBER

(54) 発明の名称: イオンピーム装置およびイオンビーム加工方法、ホルダ部材



(57) Abstract: An ion beam device comprises a holder member (21) for holding a sample (3), and a removing beam source (13) for radiating inactive ion beams to the cross section (4) of the sample (3) held in the holder member (21), so as to remove the crushed layer of the cross section (4). And the removing beam source (13) is positioned on the holder end side of the sample (3) with respect to a line (L) perpendicular to the cross section (4), and the direction of the radiation of inactive ion beam to the cross section (4) is tilted at a tilt angle ( $\theta$ ) with respect to the perpendicular line (L).

(57) 要約: 試料(3)を保持するホルダ部材(21)と、このホルダ部材(21)に保持された試料(3)の断面(4)に不活性イオンビームを照射して断面(4)上の破砕層を除去するための除去用ビーム源(13)とを備える。そして、除去用ビーム源(13)は、断面(4)の垂線Lに対して試料(3)の保持端側に位置されて、断面(4)に対する不活性イオンビームの照射方向が、垂線Lに対して傾斜角 $\theta$ 

[続葉有]

VO 2004/008475 A1



〒261-8507 千葉県 千葉市 美浜区中瀬 1 丁目 8 番地 添付公開書類: セイコーインスツルメンツ株式会社内 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 坂上 正明 (SAKANOUE, Masaaki); 〒261-8507 千葉県 千葉市 美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーイ ンスツルメンツ株式会社内 Chiba (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

#### 明細書

イオンビーム装置およびイオンビーム加工方法、ホルダ部材

#### 5 技術分野

本発明は、例えば半導体等の微細構造を観察するための試料に、観察用の断面を加工するためのイオンビーム装置およびイオンビーム加工方法、ホルダ部材に関する。

#### 10 背景技術

15

20

25

従来、例えば、半導体メモリ等のウェハの製造過程等で発生した欠陥をTEM(Transmission Electron Microscope)等によって観察するためのTEM用試料を作製する用途として、イオンビーム装置が広く普及している。この種のイオンビーム装置では、集束イオンビーム(FIB:Focused Ion Beam)によるイオンビーム加工によって、TEM用試料の特定箇所に観察するための微細な断面を加工することを可能にし、比較的短時間にTEM用試料を作製することが可能にされている。

しかしながら、従来のイオンビーム装置を用いて試料に微細な断面を 形成するイオンビーム加工を行った場合には、集束イオンビームのイオ ン源に用いられているガリウムが試料の断面に注入されて変質される ことでアモルファス状になるとともに、ガリウムによって断面が損傷さ れたダメージ層いわゆる破砕層が形成されてしまう。このような破砕層 が観察用の断面上に形成された試料は、破砕層が、比較的高倍率のTE M観察に悪影響を及ぼすため、正常な結晶格子像が得られない等の不都 合があり、断面の原子レベルまで高精度に観察する際に問題があった。 したがって、試料の断面上に形成された30nm程度の破砕層を10n

15

20

25



m程度まで薄くするように破砕層を除去することが必要であった。

そこで、集東イオンビームの加速エネルギを小さくして破砕層の厚さを減少させることや、集東イオンビームによる加工後に断面に比較的低エネルギのイオンビームを照射して断面上に形成された破砕層を除去することが考えられている。また、破砕層を除去するためのイオンビームを断面に照射することによっても断面に新たに破砕層が形成されてしまうが、例えばアルゴンイオンビームを用いた場合に形成される破砕層は数nm程度であるため、断面を観察する上で支障をきたさない。

このため、従来のイオンビーム装置としては、集束イオンビームが照 10 射されて加工された試料の断面にアルゴンイオンビームを照射して断 面上の破砕層を除去するための除去用ビーム部を備える装置が提案さ れている。

このような従来のイオンビーム装置は、試料を保持するためのホルダ部と、試料に断面を加工するための加工用ビーム部と、試料に加工された断面上の破砕層を除去するための除去用ビーム部と、試料の断面を観察するための観察用ビーム部とを備えている。ホルダ部は、試料を先端側に保持するホルダ部材を有している。加工用ビーム部は、ホルダ部材に保持された試料の天面側に対向する鉛直上方に配置されている。除去用ビーム部および観察用ビーム部は、試料の断面を挟んで対向する位置に配置されている。

以上のように構成された従来のイオンビーム装置は、加工用ビーム部が、ホルダ部材に保持された試料にガリウムイオン源からの集束イオンビームを照射することによって断面を加工し、除去用ビーム部が、試料の断面にアルゴンイオンビームを照射することによって断面から破砕層を除去する(イオンミリング)。そして、観察用ビーム部は、破砕層が除去された試料の断面に電子ビームを照射することにより、試料の断



面の観察像が得られる。

ところで、上述した従来のイオンビーム装置は、図12に示すように、 試料103の断面104にアルゴンイオンビームを照射する際に、アルゴンイオンビームが試料103の断面104以外の領域まで広範囲に 照射されしまう。このため、試料103の断面104の基端側に隣接す る段差部等に照射されたアルゴンイオンビームの一部は、段差部の天面 等に照射されることによって破砕層の二次粒子を飛散させて、除去され た破砕層の二次粒子を断面104に再付着させて汚損してしまう問題 があった。

10 そこで、本発明は、試料の加工面から破砕層を良好に除去することができるイオンピーム装置およびイオンビーム加工方法、ホルダ部材を提供することを目的とする。

#### 発明の開示

る。

上述した目的を達成するため、本発明に係るイオンビーム装置は、試料を保持するホルダ部材と、このホルダ部材に保持された試料の、集束イオンビームが照射されて形成された加工面に気体イオンビームを照射して加工面上の破砕層を除去するための除去用ビーム源とを備える。そして、気体イオンビームは、加工面に垂直な方向に対して試料の保持端側から、照射方向を、前記垂直な方向に対して傾斜させて照射される。以上のように構成した本発明に係るイオンビーム装置によれば、試料に気体イオンビームを照射して破砕層を除去する際、加工面に隣接して形成される段差部に気体イオンビームが照射されることによって飛散された二次粒子が加工面に到達しない方向に進むため、気体イオンビームによって除去された破砕層が加工面に再度付着することが軽減され

10

15

20

また、本発明に係るイオンビーム装置が備えるホルダ部材は、水平方向に平行な第1の軸回りに回動可能に支持された基体部と、この基体部の先端側に第1の軸に直交する第2の軸回りに回動可能に設けられて試料を保持する保持部とを有することが好ましい。ホルダ部材は、第1の軸回りに回動可能に設けられることによって、ホルダ部材に対する除去用ビーム源の配置や気体イオンビームの照射方向の自由度が確保される。また、ホルダ部材は、第2の軸回りに回動可能に設けられた保持部を有することによって、保持部に保持された試料に対する集束イオンビームおよび気体イオンビームの照射方向を変化させることが可能になる。

また、本発明に係るイオンビーム加工方法は、試料に集束イオンビームを照射して加工面を形成する第1の工程と、試料の加工面に気体イオンビームを照射して加工面上の破砕層を除去する第2の工程とを有する。そして、第2の工程では、試料の加工面に垂直な方向に対して試料の保持端側から、気体イオンビームの照射方向を前記垂直な方向に対して傾斜させて照射する。

以上のように構成した本発明に係るイオンビーム加工方法は、第2の工程で、試料の加工面に垂直な方向に対して試料の保持端側から、気体イオンビームの照射方向を前記垂直な方向に対して傾斜させて照射することで、気体イオンビームが加工面に隣接して形成される段差部に照射されることによって飛散された破砕層の二次粒子が加工面に到達しない方向に進むため、気体イオンビームによって除去された破砕層の二次粒子が加工面に再度付着することが軽減される。

また、本発明に係るホルダ部材は、水平方向に平行な第1の軸回りに 25 回動可能に支持される基体部と、この基体部の先端側に第1の軸に直交 する第2の軸回りに回動可能に設けられ集束イオンビームが照射され

10

15

20

て加工面が形成される試料を保持する保持部とを有する。

以上のように構成した本発明に係るホルダ部材によれば、試料にイオンビームを照射して加工面を形成する際に、イオンビームの照射方向に対して保持部を第2の軸回りに回動させることにより、試料の加工面に対するイオンビームの照射方向を変化させることが可能になる。したがって、保持部に保持された試料は、加工面に対するイオンビームの照射方向を変化させて、イオンビームによる加工を複数回繰り返すことによって、試料の天面上に微小な凹凸や異なる材質の境界が存在する場合に加工面に生じるスジが次第に小さくされ、スジが取り除かれる。なお、試料は、加工面に対するイオンビームの照射方向を変化させながらイオンビームによる加工が行われても上述したスジが取り除かれる。

なお、上述した気体には、試料の特性に顕著な影響を及ぼさないような例えば酸素、アルゴン、ヘリウム、ネオン、キセノン、クリプトン、ラドン等が挙げられる。

また、本発明における破砕層とは、例えば、試料の加工面にガリウムの集束イオンビームを照射した場合に、加工面にガリウムが注入されて変質されることでアモルファス状になるとともにガリウムによって損傷された層を指している。

また、上述した試料の保持端側とは、ホルダ部材に保持された試料の、ホルダ部材上に当接された端部側を指し、例えば試料の細片がダイス等の支持体を介してホルダ部材に保持される場合には、支持体が当接されるホルダ部材の保持面に対向する試料の端部側を指している。

#### 図面の簡単な説明

25 図1は、本発明に係るイオンビーム装置を模式的に示す断面図である。 図2は、図1に示すイオンビーム装置を模式的に示すA-A断面図で ある。

5

10

20

図3は、(a)は断面が加工される試料を示す斜視図、(b)は断面が加工された試料を示す斜視図である。

図4は、ホルダ部材の保持部を模式的に示す透視側面図である。

図5は、前記保持部および摺動板を示す模式図である。

図 6 は、前記保持部を駆動する他の駆動機構の一例を模式的に示す透 視側面図である。

図7(a)は試料に断面を加工する状態を示す模式図、図7(b)は 試料の断面に不活性イオンビームが照射される状態を示す模式図、図7 (c)は試料の断面に電子ビームが照射される状態を示す模式図である。 図8は、試料の断面に照射される不活性イオンビームの照射方向に対 して断面を回動させて加工する状態を示す模式図である。

図9は、試料の断面に不活性イオンビームが照射される状態を説明するための模式図である。

15 図 1 0 は、他のイオンビーム装置の一例を模式的に示す断面図である。 図 1 1 は、従来のイオンビーム装置において、試料の断面に不活性イ オンビームが照射される状態を模式的に示す断面図である。

図12(a)は集東イオンビームによって断面が形成される試料を示す模式図、図12(b)は集束イオンビームによって断面上にスジが形成された試料を示す模式図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の具体的な実施形態を図面を参照して説明する。

図1および図2に示すように、本実施形態のイオンビーム装置1は、 25 いわゆるサイドエントリー型のイオンビーム装置であり、内部で試料3 を加工するための真空容器10と、試料3を保持するためのホルダ部1

10

15

20

25

1と、試料3にガリウムイオン源からの集束イオンビームを照射して観察用の断面を加工するための加工用ビーム部12と、試料3に加工された断面に不活性イオンビームを照射して断面上の破砕層を除去するための除去用ビーム部13と、試料3の断面に電子ビームを照射して断面を観察するための観察用ビーム部14とを備えている。

まず、イオンビーム装置1によって加工される試料3は、ウェハから 所定の平板状に切り出された後、幅方向の両側が切り落とされることに より、図2(a)に示すようなブロック状に予め加工されている。そし て、このブロック状の試料3は、幅W<sub>1</sub>が0.1~0.5mm程度に形 成されており、本実施形態のイオンビーム装置1によって、図3(b) に示すように、幅方向の両側に、観察用の断面4がそれぞれ加工されて、 例えば先端側の幅W<sub>2</sub>が数十μm程度に形成される。

なお、試料3には、断面4で反射された二次電子を検出する反射方式を用いる場合には、幅方向の片側のみに加工面が形成される。また、本実施形態のイオンビーム装置1によって断面4が観察される試料3としては、上述したようなダイシング法によってブロック状に切り出された後に断面が形成された試料の以外に、いわゆるピックアップ法あるいはリフトアウト法によって、断面が加工された細片が切り出されてダイス上に接合された試料が適用されてもよい。

真空容器10は、内部に試料3の加工および観察を行うための真空室 15を有しており、支持台16上に固定されて設けられている。真空室 15は、排気管17を介して排気装置(不図示)に連通されている。

ホルダ部11は、真空容器10の側面部に配置されており、試料3を図1中矢印a 1, a 2方向、および b 1, b 2方向にそれぞれ回動可能に保持するロッド状のホルダ部材21を有している。

ホルダ部材21は、図4および図5に示すように、長手方向が水平方

10

向と平行に設けられた基体部22と、基体部22の基端側を a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> 方向に回動可能に支持するホルダ支持機構23と、基体部22の先端側に b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>方向に回動可能に設けられて試料を保持する保持部24と、この保持部24を基体部22に対して回動させるための摺動板25とを有している。

基体部 2 2 は、ホルダ支持機構 2 3 によって例えば a 1 方向に 1 4 5 度程度、a 2 方向に 3 5 度程度回動可能に支持されている。

保持部24は、略半円をなす平板状に形成されており、試料3が載置されて固定される載置凹部27を有している。この保持部24は、回動軸28を介して基体部22上にb<sub>1</sub>,b₂方向に回動可能に支持されており、例えば±30度程度回動可能にされている。また、載置凹部27には、載置された試料3の保持端側が例えばデポジション膜やはんだ材によって接合され固定されている。

摺動板25は、基体部22の長手方向に沿って図4中矢印 c 1, c 2 方向に摺動可能に設けられている。摺動板25は、先端側が保持部24の円弧状の外周部に摺接されており、基端側が真空容器10の外方に引き出されている。そして、摺動板25は、例えば手動で c 1, c 2方向に操作されることによって、摺動量に応じて保持部24を b 1, b 2方向に回動させる。

また、例えば図6に示すように、保持部24は、プーリ31とこのプーリ31に掛け渡されたベルト32とを有する駆動機構によって回動されるように構成されてもよい。また、図示しないが、この駆動機構は、ベルトの替わりにワイヤやギヤ等を用いて構成されてもよい。さらに、ホルダ部材21には、保持部24に、載置凹部27に載置された試料3
 を挟持する、いわゆるクランプ機構が設けられる構成にされてもよい。加工用ビーム部12は、例えば集束イオンビーム照射装置であって、

10

15

20

25

その鏡筒は、真空容器 1 0 の鉛直上方に配置されており、加工用ビーム源(不図示)であるガリウム液体金属イオン源と、このガリウム液体金属イオン源からのイオンビームを集束し走査照射するイオン光学系を有している。この加工用ビーム部は、試料 3 に対する集束イオンビームの照射軸(鏡筒の中心軸)が鉛直方向となるように配置されている。

9

除去用ビーム部13は、例えば気体イオンビーム照射装置であって、 試料3の断面4に臨む位置に配置されており、例えばアルゴンガス、ヘ リウムガス等の不活性ガスの不活性イオンビームを照射する除去用ビ ーム源(気体イオン銃)(不図示)を有している。除去用ビーム部13 は、試料3の断面4に向かうその照射軸(鏡筒の中心軸)が、水平方向 に対して斜め上方に35度程度傾斜するように配置されている。なお、 除去用ビーム源は、必要に応じて酸素を用いた酸素イオンビームを照射 するように構成されてもよく、このときの化学種が、酸素イオンの他に 酸素ラジカルであってもよい。

観察用ビーム部14は、例えば電子ビーム照射装置であって、試料3の断面4に臨む位置に配置されており、電子ビームを照射する電子銃(不図示)と、この電子銃から照射されて試料3の断面4を透過した透過電子を検出するTEM用の検出器33とを有している。観察用ビーム部14は、その照射軸(鏡筒の中心軸)が水平方向に対して斜め上方に35度程度傾斜するように配置されている。検出器33は、図1および図7(c)に示すように、試料3の断面4を挟んで電子銃に対向する位置に設けられている。なお、上述した観察用ビーム部14は、透過方式が採られたが、例えば検出器が試料3の天面側に臨む位置に配置されて、断面4で反射された二次電子を検出する反射方式が適用された構成にされてもよい。

以上のように構成されたイオンビーム装置1を用いて、試料3に観察

10

15

20

25

用の断面 4 を加工するとともに、この断面 4 を観察する方法を図面を参照して説明する。

まず、イオンビーム装置1は、図7(a)に示すように、試料3に断面4を加工する際、ホルダ部材21の保持部24に試料が保持された初期位置で、試料3の天面に対して集束イオンビームの照射方向が略直交されている。この初期位置で、加工用ビーム源は、試料3に集束イオンビームを照射することによって断面4を形成する。

ここで、従来から、試料に集束イオンビームを照射して断面を加工する際に発生している問題について簡単に説明する。

図8(a)に模式的に示すように、加工用ビーム源側に臨む試料108の天面(表面)109上に凹部111が存在する場合には、試料108の天面109の形状によって加工速度にバラツキが生じるため、図8(b)に示すように凹部111の境界に集束イオンビームの照射方向に沿って凹凸状のスジ112が断面110上に発生してしまう問題がある。また、このようなスジ112は、試料108の天面109上に材質が異なる境界がある場合にも発生している。また同様に、断面110から破砕層を除去する際に、試料108の断面110にアルゴンイオンビームを照射した場合にも、スジが発生してしまうという問題があった。そして、このようなスジ112が試料108の断面110上に発生することにより、観察用ビーム部によって観察を行う際に、断面110の良好な観察像を得る上で支障になっていた。

このような問題の対策として、本実施形態では、集束イオンビームによって試料3に断面4を加工する際、図9に示すように、保持部24を b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>方向に回動させることにより、集束イオンビームの照射方向に対して断面4を所望の角度だけ傾斜させた回動位置で、それぞれ集束イオンビームによる加工を少なくとも2回以上繰り返す。これにより、

20

25

試料3の断面4には、試料3の天面上に存在する微小な凹凸や異なる材質の境界によって生じるスジが、加工を繰り返す度に取り除かれて次第に小さくなり、スジが目立たない平滑な断面4が形成される。

11

つぎに、イオンビーム装置1は、図7(b)に示すように、ホルダ部材21を初期位置から例えばa<sub>1</sub>方向に145度程度回転させることによって、保持部24に保持された試料3の断面4に対して照射される、除去用ビーム部13による不活性イオンビームの照射方向が調整される。

すなわち、ホルダ部材 2 1 に保持された試料 3 は、図 1 0 に示すよう 10 に、断面 4 に不活性イオンビームが照射されたとき、断面 4 に対して垂直な垂線しに対して、試料 3 の保持端側に除去用ビーム源が位置されており、断面 4 に照射される不活性イオンビームの照射方向が、垂線しに対して傾斜角  $\theta$  をもって傾斜されている。傾斜角  $\theta$  は、 9 0 ° >  $\theta$  > 0 ° の範囲であり、試料 3 の形状や保持部 2 4 の大きさ等によるが、で 15 きるだけ  $\theta$  は大きな角度の方がよく、本実施形態で例えば 7 0 ~ 8 0 度程度に設定されている。

そして、試料 3 は、断面 4 に対する不活性イオンビームの照射方向が、 垂線 L に対して傾斜角 θ だけ傾斜されることによって、断面 4 に隣接する段差部の側面に照射された不活性イオンビームによって飛散された 破砕層の二次粒子が断面 4 に到達しない方向に進むため、断面 4 の破砕 層から除去された二次粒子が断面 4 上に再度付着して、断面 4 が汚損されることが軽減される。

また同様に、不活性イオンビームによって試料3の断面4から破砕層を除去する際にも、図9に示したように、保持部24をb<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>方向に回動させることにより、不活性イオンビームの照射方向に対して断面4を所望の角度だけ傾斜させた回動位置で、それぞれ不活性イオンビー

10

15

20

25

ムによる加工を少なくとも2回以上繰り返す。これにより、試料3の断面4には、試料3の天面上に存在する微小な凹凸や異なる材質の境界によって生じるスジが、加工を繰り返す度に取り除かれて次第に小さくなり、スジが目立たない平滑な断面4が形成される。

12

さらに、試料3は、上述した一方の断面4に不活性イオンビームが照射された回動位置からa2方向に40度程度させた回動位置で、他方の断面4に対して不活性イオンビームが照射されて破砕層が除去される。

なお、上述した集束イオンビームによる断面 4 の加工時および不活性イオンビームによる破砕層の除去時には、試料 3 の断面 4 上に生じる上述したスジを取り除くために、保持部 2 4 を b 1 , b 2 方向に回動させながら試料 3 に集束イオンビームまたは不活性イオンビームを照射することによって、試料 3 に対する集束イオンビームまたは不活性イオンビームの照射方向を変化させながら加工を行ってもよい。

また、本実施形態では、集束イオンビームによる断面 4 の加工時および不活性イオンビームによる破砕層の除去時にそれぞれスジを取り除くために保持部 2 4 を回動させたが、不活性イオンビームによる破砕層の除去時に一括してスジを取り除いてもよい。なお、不活性イオンビームによってスジを一括して除去する場合には、断面 4 に対する不活性イオンビームの照射方向を、試料 3 に対する集束イオンビームの照射方向と異ならせる必要がある。

最後に、イオンビーム装置1は、図7(c)に示すように、ホルダ部材21を、不活性イオンビームを照射した回動位置から例えばa₂方向に180度回動させて、すなわち初期位置に対してa₂方向に35度回動させることによって、保持部24に保持された試料3の断面4に対して照射される、観察用ビーム部14による電子ビームの照射方向が調整される。この回動位置で、観察用ビーム部14は、試料3の断面4に電

15

20

25

子ピームを照射して、断面 4 を透過した透過電子を検出器 3 3 が検出することによって、断面 4 の良好な観察像が得られる。

上述したように、イオンビーム装置1は、ホルダ部材21をa<sub>1</sub>, a₂方向に回動させて、試料3の断面4に対する不活性イオンビームの照射方向が、断面4の垂線Lに対して傾斜角θだけ傾斜させて破砕層を除去することによって、除去された破砕層の二次粒子が断面上に再付着することを軽減できる。このため、このイオンビーム装置1によれば、破砕層が良好に除去された平滑な断面4を得ることが可能になり、観察用ビーム部14によって断面4を良好に観察することができる。

10 また、イオンビーム装置1が備えるホルダ部11は、 b₁, b₂方向に回動可能に設けられた保持部24を有するホルダ部材21を有することによって、集東イオンビームによって加工される試料3の断面4に生じるスジを小さくすることが可能になり、断面4の平滑性を向上することができる。

最後に、上述したイオンビーム装置1は、除去用ビーム部13が、ホルダ部材21上の試料3に対して斜め上方に配置されたが、除去用ビーム部13が他の位置に配置された他のイオンビーム装置について簡単に説明する。なお、他のイオンビーム装置は、上述したイオンビーム装置1と比して除去用ビーム部13および観察用ビーム部14の位置のみが異なるため、同一部材には同一符号を付して説明を省略する。

図11に示すように、他のイオンビーム装置2は、除去用ビーム部13が、ホルダ部材21上の試料3に対して斜め下方から不活性イオンビームを照射するように配置されるとともに、観察用ビーム部14が、ホルダ部材21上の試料3に対して水平方向から電子ビームを照射するように配置されている。

このように構成されたイオンビーム装置2によれば、ホルダ部材21

を a 1 , a 2 方向に回動させる必要がなくなり、ホルダ部材 2 1 の構成を簡素化することができる。また、イオンビーム装置は、ホルダ部材 2 1 の a 1 , a 2 方向の回動可能な角度範囲に応じて、試料 3 の断面 4 に対する除去用ビーム部 1 4 の相対位置が設定されてもよい。

したがって、本発明に係るイオンビーム装置は、不活性イオンビームが、試料3の断面4の垂線Lに対して試料3の保持端側から、照射方向を垂線Lに対して傾斜させて照射される構成であれば、ホルダ部11、除去用ビーム部13、観察用ビーム部14が他の任意の位置に配置される構成とされてよい。

なお、本実施形態は、加工用ビーム部12を備えるサイドエントリー型のイオンビーム装置1として構成されたが、この構成に限定されるものでなく、例えば、加工用ビーム部12を備えずに上述したホルダ部10および除去用ビーム部13を備える構成や、さらにこの構成に観察用ビーム部14が加えられた構成にされてもよい。

15

20

10

5

#### 産業上の利用可能性

上述したように本発明に係るイオンビーム装置によれば、気体イオンビームが、試料の加工面に垂直な方向に対して試料の保持端側から、照射方向を前記垂直な方向に対して傾斜させて照射する除去用ビーム源を備えることによって、気体イオンビームによって除去された破砕層が加工面に再度付着することが軽減される。したがって、本発明のイオンビーム装置は、加工面から破砕層を良好に除去することが可能になり、平滑な加工面を得ることができる。

また、本発明に係るイオンビーム装置は、ホルダ部材が、水平方向に 25 平行な第1の軸回りに回動可能に支持された基体部と、この基体部の先 端側に第1の軸に直交する第2の軸回りに回動可能に設けられて試料 を保持する保持部とを有することによって、ホルダ部材に対する除去用 ビーム源の配置や気体イオンビームの照射方向の自由度を確保すると ともに、保持部に保持された試料の加工面に対するイオンビームの照射 方向を変化させることが可能になる。

また、本発明に係るイオンビーム加工方法によれば、第2の工程で、 試料の加工面に垂直な方向に対して試料の保持端側から、気体イオンビームの照射方向を前記垂直な方向に対して傾斜させて照射することに よって、気体イオンビームによって除去された破砕層が加工面に再度付 着することを軽減することが可能になり、加工面から破砕層を良好に除 去して平滑な加工面を得ることができる。

また、本発明に係るホルダ部材によれば、水平方向に平行な第1の軸回りに回動可能に支持される基体部と、この基体部の先端側に第1の軸に直交する第2の軸回りに回動可能に設けられ集東イオンビームが照射されて加工面が形成される試料を保持する保持部とを有することによって、試料の加工面に対する集東イオンビームおよび気体イオンビームの照射方向を変化させることが可能になる。したがって、本発明のホルダ部材によれば、集東イオンビームまたは気体イオンビームの照射方向を変化させて加工を行うことで、加工面にスジが生じることを軽減できるため、加工面の平滑性を向上することができる。

5

10

15

#### 請求の範囲

1.試料を保持するホルダ部材と、

前記ホルダ部材に保持された試料の、集束イオンビームが照射されて 5 形成された加工面に、気体イオンビームを照射して前記加工面上の破砕 層を除去するための除去用ビーム源とを備え、

前記気体イオンビームは、前記加工面に垂直な方向に対して前記試料の保持端側から、照射方向を前記垂直な方向に対して傾斜させて照射されるイオンビーム装置。

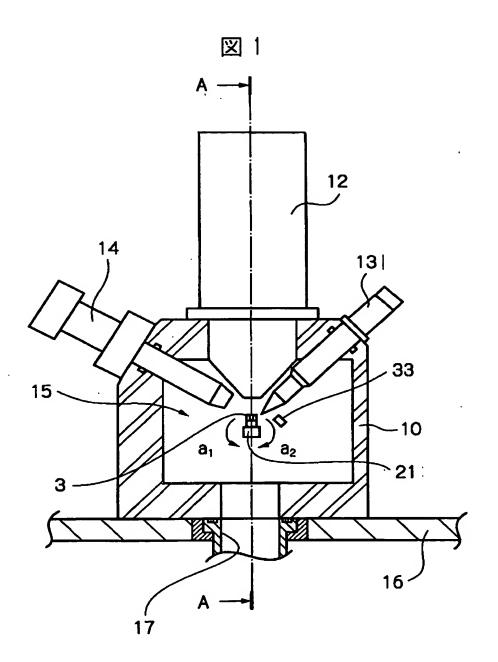
- 10 2.前記ホルダ部材に保持された試料に集束イオンビームを照射して前記加工面を形成するための加工用ビーム源を備える請求項1に記載のイオンビーム装置。
  - 3. 前記気体イオンビームは、不活性ガスイオンビームである請求項1 または2に記載のイオンビーム装置。
- 15 4.前記ホルダ部材は、水平方向に平行な第1の軸回りに回動可能に支持された基体部と、前記基体部の先端側に前記第1の軸に直交する第2の軸回りに回動可能に設けられて試料を保持する保持部とを有する請求項1ないし3のいずれか1項に記載のイオンビーム装置。
- 5. 前記ホルダ部材は、前記保持部を前記第2の軸回りに回動させるた 20 めの駆動手段を有する請求項4に記載のイオンビーム装置。
  - 6.前記試料の加工面に電子ビームを照射して該加工面を観察するための観察用ビーム源を備える請求項1ないし5のいずれか1項に記載のイオンビーム装置。
- 7.前記加工用ビーム源は、前記試料に対して集束イオンビームを鉛直 25 上方から照射する請求項2ないし6のいずれか1項に記載のイオンビーム装置。

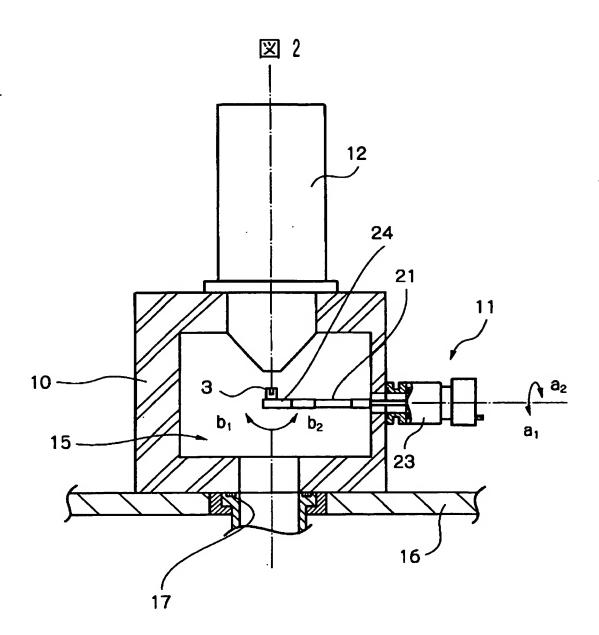


8.試料に集東イオンビームを照射して加工面を形成する第1の工程と、 試料の前記加工面に気体イオンビームを照射して前記加工面上の破 砕層を除去する第2の工程とを有し、

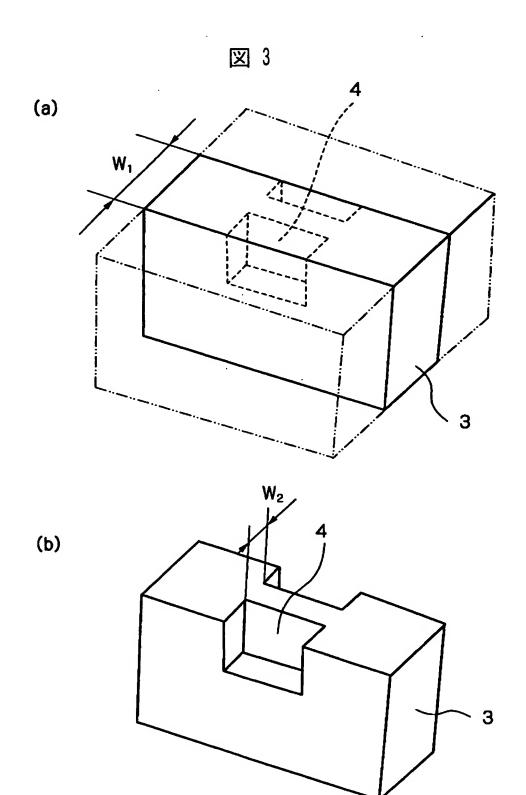
前記第2の工程では、試料の加工面に垂直な方向に対して該試料の保 5 持端側から、気体イオンビームの照射方向を前記垂直な方向に対して傾 斜させて照射するイオンビーム加工方法。

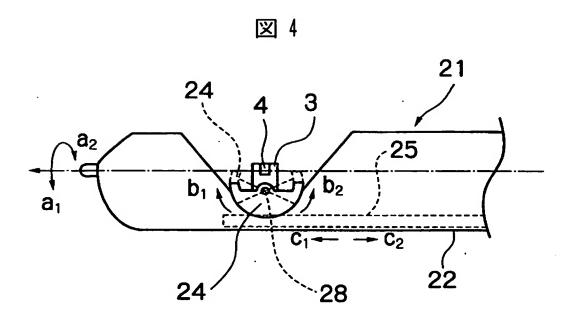
- 9. 前記気体イオンビームは、不活性ガスイオンビームである請求項8に記載のイオンビーム加工方法。
- 10.前記第2の工程では、試料に対する前記気体イオンビームの照射 10 方向を変化させて加工する請求項8または9に記載のイオンビーム加工方法。
- 1 1.前記第1の工程では、試料に対する前記集束イオンビームの照射方向を変化させて加工する請求項10に記載のイオンビーム加工方法。12.前記第1の工程または前記第2の工程では、試料を保持するホルグを介して、該試料を前記集束イオンビームまたは前記気体イオンビームの照射方向に対して移動させる請求項10または11に記載のイオンビーム加工方法。
- 13.水平方向に平行な第1の軸回りに回動可能に支持される基体部と、前記基体部の先端側に前記第1の軸に直交する第2の軸回りに回動 可能に設けられて、集束イオンビームが照射されて加工面が形成される 試料を保持する保持部とを有するホルダ部材。
  - 14.前記保持部を前記第2の軸回りに回動させるための駆動手段を有する請求項13に記載のホルダ部材。

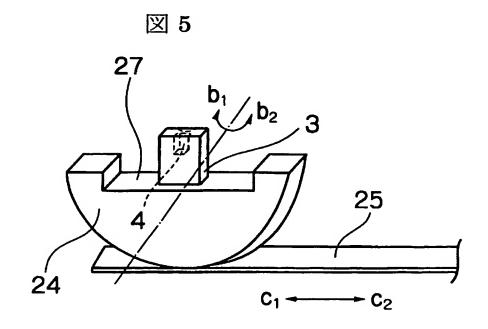


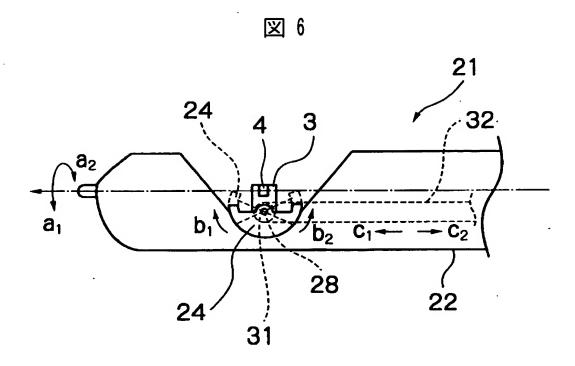


ç,

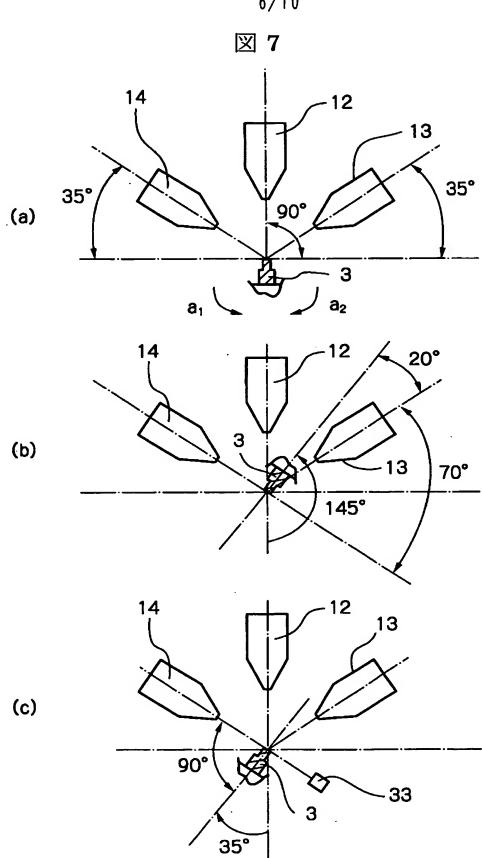


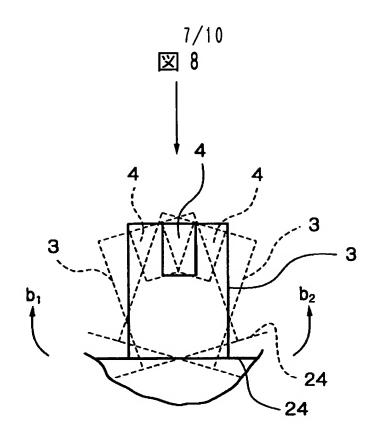


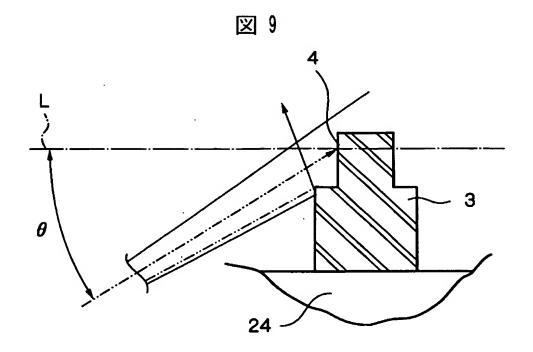














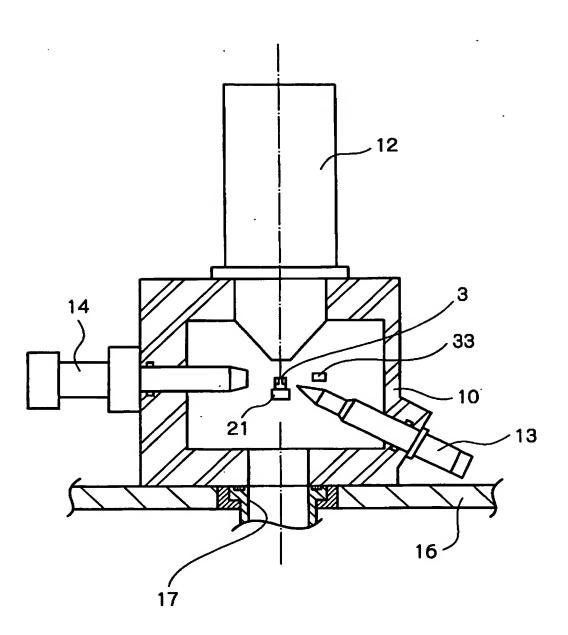




図 11

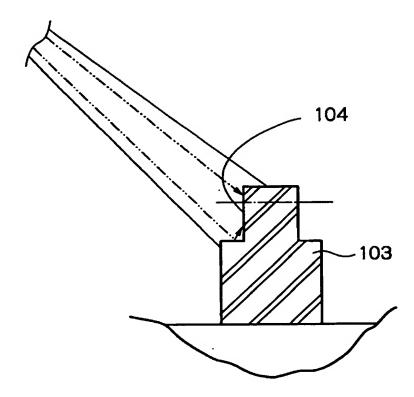
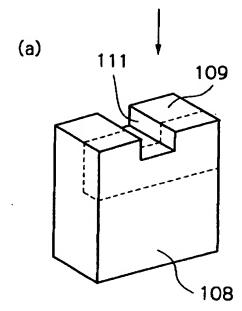
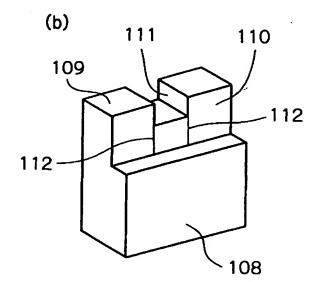


図 12





	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 <sup>7</sup> H01J37/30, 37/317, 37/20,	G01N1/28, H01L21/302	
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELD	S SEARCHED		
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 H01J37/30, 37/317, 37/20,	by classification symbols) G01N1/28	
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003			
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) .			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ag	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y .	JP 2000-258314 A (NEC Corp.) 22 September, 2000 (22.09.00) Full text; all drawings (Family: none)		1-12
Y	JP 10-221227 A (Matsushita E 21 August, 1998 (21.08.98), Full text; all drawings (Family: none)	Electronics Corp.),	1-12
Y	JP 4-120437 A (Hitachi, Ltd. 21 April, 1992 (21.04.92), Page 6, lower left column, lupper left column, line 17; (Family: none)	ine 17 to page 7,	4-6,10-12
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search  O O October, 2003 (09.10.03)  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive		the application but cited to certying the invention claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be to when the document is documents, such skilled in the art family	
Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer			
Japa	Japanese Patent Office		
Facsimile No.		Telephone No.	



Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP 8-106873 A (Hitachi, Ltd.), 23 April, 1996 (23.04.96), Fig. 3 (Family: none)	4,5
Y	JP 3-254055 A (Hitachi, Ltd.), 13 November, 1991 (13.11.91), Fig. 3 (Family: none)	4,5
Y	JP 4-116843 A (Hitachi, Ltd.), 17 April, 1992 (17.04.92), Full text; all drawings (Family: none)	6
A	JP 10-84020 A (Hitachi, Ltd.), 31 March, 1998 (31.03.98), Full text; all drawings (Family: none)	1-12
A	JP 2001-84951 A (Hitachi, Ltd.), 30 March, 2001 (30.03.01), Full text; all drawings (Family: none)	1-12
P,A	JP 2002-208374 A (Seiko Instruments Inc.), 26 July, 2002 (26.07.02), Full text; all drawings (Family: none)	1-12
	JP 6-260129 A (Seiko Instruments Inc.), 16 September, 1994 (16.09.94), Full text; all drawings & US 5574280 A & KR 364207 B	1-12



Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
Claims Nos.:  because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. Claims Nos.:  because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:  because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:  Claims 1-12 relate to the direction of radiation of gas ion beams for removing a crushed layer.  In contrast therewith, Claims 13, 14 relate to the construction of a holder member, and the description given concerning the radiation ion beam is of a focused ion beam alone for forming a processed surface.  These inventions do not form a single general inventive concept.
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.   No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1-12
Remark on Protest  The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.

#### A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01J37/30, 37/317, 37/20, G01N1/28, H01L21/302

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01J37/30, 37/317, 37/20, G01N1/28

#### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

# C. 関連すると認められる文献 引用文献の カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示

ルノーソーチ	引用人間名 及び 即の固川が民産することは、この民産する国川の気が	MINISTER HEADEN IN 121 13
Y	JP 2000-258314 A (日本電気株式会社) 2000.09.22,全文,全図(ファミリーなし)	1-12
Y	JP 10-221227 A (松下電子工業株式会社) 1998.08.21,全文,全図 (ファミリーなし)	1-12
Y	JP 4-120437 A (株式会社日立製作所) 1992.04.21	4-6, 10-12
	第6頁左下欄17行-第7頁左上欄17行,第9図,第6図	

#### x C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの

(ファミリーなし)

- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

09.10.03

国際調査報告の発送日

28. 10. 03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 堀部 修平 2G 9215

関連する

請求の範囲の番号

電話番号 03-3581-1101 内線 3225

C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する 請求の範囲の番号
<i>Э</i> у	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP 8-106873 A (株式会社日立製作所) 1996.04.23,図3 (ファミリーなし)	4, 5
Y	JP 3-254055 A (株式会社日立製作所) 1991.11.13,第3図 (ファミリーなし)	4, 5
Y	JP 4-116843 A (株式会社日立製作所) 1992.04.17,全文,全図 (ファミリーなし)	6
A	JP 10-84020 A (株式会社日立製作所) 1998.03.31,全文,全図 (ファミリーなし)	1-12
A	JP 2001-84951 A (株式会社日立製作所) 2001.03.30,全文,全図(ファミリーなし)	1-12
P, A	JP 2002-208374 A (セイコーインスツルメンツ株式会社) 2002.07.26,全文,全図(ファミリーなし)	1-12
A	JP 6-260129 A (セイコー電子工業株式会社) 1994.09.16,全文,全図 & US 5574280 A & KR 364207 B	1-12

第Ⅰ欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条 成しなか	等3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作いった。
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 🗌	請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 🗍	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に対	べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
のて ご ビー	情求の範囲1-12は、破砕層を除去するための気体イオンビームの照射方向に関するもである。 はれに対し、請求の範囲13,14はホルダ部材の構造に関するものであり、照射イオントムについても加工面を形成するための集束イオンビームが記載されているのみである。 はれらの発明は、単一の一般的発明概念を形成していない。
1. 🗍	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
_	の範囲について作成した。
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. x	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。 請求の範囲1-12
追加調査	至手数料の異議の申立てに関する注意 ] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。 ] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
$\square$ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
ILINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
$\square$ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.